

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 第2四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2023年11月2日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2023年度(2024年3月期) 第2四半期 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. SPEの受注について、生成AI関連の受注実績を伺いたい。

- 生成AI関連では、ロジック半導体もしくはHBM用途で、上期、主に7-9月期に約60-70億円の受注を計上。ロジック/HBM比率は4:6程度。
- 下期も同水準の受注高を想定している。

2. 7-9月期SPE受注高(220億円)は、会社想定(4-6月期比横ばい)を上振れた。生成AI関連受注を踏まえると、それ以外の用途の受注高が大幅に下振れたのではないか。

- AI関連の事業機会は従前より存在したが、直近の生成AI関連需要については特に織り込んでいなかった。
- 一部には堅調なデバイス(SiC関連、中国市場、CIS等)もあるが、民生関連・シリコン系パワー半導体関連・ならびに一部のアナログ半導体関連の需要は落ち込んでいる。なお、これに関連して、当面の出荷確度が低下した受注残高 約10億円を取消処理している。
- なお、下期の受注高予想は、現時点で想定される生成AI関連の事業機会を織り込んでいる。

3. 7-9月期のSPE受注高・売上高に占めるパワー半導体ならびにSiC向けの構成比を伺いたい。また、この構成比が今後どのように変化するか確認したい。

- 7-9月期のパワー半導体向け構成比は、受注高で約14%、売上高で17%程度。うちSiC用途はそれぞれ半分強と推定。なお、プローバについては、顧客の測定デバイスがシリコンかSiCかが判別しづらいケースがある。
- 足許では、シリコン系パワー半導体の需要が欧州を中心に落ち込んでいる。一方で

SiC に関しては増加基調にあると認識している。

- SiC の構成比は、足許でプローバの商談があることや、グラインダ需要の拡大が期待されることから、今後も増加すると想定している。

4. 7-9 月期の SPE 受注高・売上高における中国向けの構成比、顧客業界別の強弱感、さらに今後の構成比の見通しについて伺いたい。

- SPE の中国向け売上構成比は平均して 30-35%程度。現時点ではメモリや CIS 等も含め、全般に需要は旺盛だと捉えている。
- 但し、下期以降この比率は上にも下にも振れる可能性はあり得る。国策により中国メーカーが台頭する可能性もあり、長期的には見通しづらい。

5. SPE 消耗品の販売動向について伺いたい。

- 従前 50 億円/年 程度であったが、現在は 70 億円/年の水準。グラインダ関係の消耗品販売が増加していることが主要因である。
- SiC 関連消耗品需要については、デバイス加工後のウェーハ研削量が、基板研削時に比べて 3 倍程度はあることから、砥石の販売が増えると期待している。

6. 会社は 10 月に子会社より充放電試験システム事業の譲受を発表しているが、この目的・期待される成果について伺いたい。

- 同子会社の受注高・売上高が増加局面に入ったことを踏まえ、グループの人的資源・設備等を最大限活用し、開発のスピードを上げて更なる成長を実現するためのもの。

7. 9 月末の SPE 受注残高(847 億円)について、納期構成、ならびに現時点での各 SPE 製品のリードタイムについて解説いただきたい。

- 9 月末の SPE 受注残のうち、概ね半分が当下期に売上を計画するほか、残りの 2/3 を 2024 年度上期、残りはそれ以降の売上を想定している。
- 一部の民生案件では納期延伸があり、2023 年度計画から 2024 年上期へシフトしている。
- リードタイムについては、プローバが 3-5 か月、ダイサが 2-4 か月、グラインダは半年-1 年程度となっている。

8. 生成 AI に関連した SPE 加工装置に関する競争環境を解説いただきたい。

- AI ロジック関連の案件は一定程度獲得できていると考える。
- HBM については、今後の Hybrid Bonding の採用において 研削精度の高い当社装置に十分チャンスがあると考えてる。

9. CMP 装置の事業環境を解説いただきたい

- 足許では SiC 向けの商談が一定量ある。
- また、Hybrid Bonding の量産を視野に入れた評価依頼が多い。

10. 会社は 2023 年度通期業績予想を修正している。売上高の修正額に対して営業利益の修正額が限定的である理由について伺いたい。

- 営業利益の増減は、ほぼ売上高の増減により説明できるものの、コストの増加(人件費、減価償却費)を想定。八王子工場近辺の借用倉庫の返却によるコスト減少はあるが、増加幅はこれを上回る。
- なお、製品ミックスによる利益率の変化は起きていない。

11. 2023 年度通期業績予想の修正にあたり、計測事業の売上高予想を下方修正しているが、足許の状況を確認したい。

- 計測事業は、全般に軟調な状況にある。
- 一方で、NEV 関連の需要は増加基調にある。充放電試験システム事業は、上期の受注高が、計測事業の 10%弱となったほか、eAxle に搭載される歯車・ギア・ケースに加え、EV 用部品・金型測定需要、更に、バッテリー・アルミダイカストの内部非破壊測定のニーズが確認されており、成長が期待できる。

12. 今後の事業機会(地政学変化による需要)として、中国の Chiplet 戦略への対応を示しているが、具体的にどのような事業機会が生じるか。

- 中国は、半導体の戦略として、デバイスを Chiplet 化し、自国で生産可能なデバイスを順次適用する動きをとると想定する。この視点では、当社の全 SPE 装置に事業機会があると考えている。

13. 会社は 2024 年度を最終年度とする中期経営計画の定量目標の達成確度は高いと説明しているが、2023 年度の業績から大きくジャンプアップすることとなる。2023 年度下期の SPE 受注見通しを踏まえ、現在の考えを伺いたい。

- 民生需要の回復のタイミングやそのボリュームが変動要因になる可能性は否定しない。現時点で回復のタイミングを見通すのは難しいが、どんなに遅くとも 2024 年夏場には回復するものと考ええる。また、回復のタイミング次第では前倒し出荷などの可能性も想定できる。

以上